

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第75號

原告 連展科技股份有限公司

代表人 林肇聰（董事長）

訴訟代理人 李文賢專利師

陳政大專利師

翁振耘專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 陳章德

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國108年8月7日經訴字第10806306960號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第0000000000號發明專利申請案，應為准予專利之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國105年1月11日以「插座電連接器」向被告申請發明專利，並以西元2015年1月15日在大陸地區申請之第000000000000.8號專利案主張優先權，經被告編為第000000000號審查，不予專利（下稱：系爭案）。原告不服，於106年11月24日申請再審查。案經被告審查，仍認本案違反專利法第26條第1項之規定，以108年2月26日（108）智專三（一）04085字第10820179180號專利再審查核駁審定書

01 為「不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以
02 108 年8 月7 日經訴字第10806306960 號決定駁回，原告不
03 服，遂向本院提起行政訴訟。

04 二、原告起訴主張：

05 （一）系爭案申請專利範圍第6 項及第9 項記載「上排接地片」
06 或「下排接地片」，既然稱為「接地片」，表示可以達到
07 接地功效，至於接地方式不受任何形式的限制，即「接地
08 片」並不一定要有接腳才能接地，依USB Type-C Cable a
09 nd Connector Specification , Release 1.0之業界標準
10 規格（原證2 ）或我國M493802 號新型專利（原證3 ），
11 可知，申請時之通常知識，即包含以接腳以外技術手段達
12 成接地，而系爭案申請專利範圍第6 項及第9 項並未記載
13 「接腳」，更未限定接地片必須「利用接腳來接地」，原
14 處分以系爭案圖式的接腳沒有顯示如何可焊接於轉接電路
15 板6 及電路板8 ，就認為系爭案申請專利範圍第6 項及第
16 9 項記載「上排接地片」或「下排接地片」不可實現，不
17 僅以申請專利範圍中未記載之發明（接腳），且錯誤認為
18 接腳是為接地片之必然構成要件而為核駁審定，明顯違反
19 專利法第26條第1 項規定。

20 （二）原處分所持「接地片若無接腳則無由接地，接腳為接地片
21 之構成要件」、「圖式之接腳與電路板無焊接可能，說明
22 書係虛偽不實」等理由，未見於被告107 年4 月9 日審查
23 意見通知函，並未給予原告適時申復及修正機會，損及申
24 請人之程序保障，違反專利法第46條第2 項規定及行政程
25 序法第102 條規定之給予陳述意見機會；又原處分未參酌
26 申請時通常知識，忽視說明書之「圖未示」記載，違反行

政程序法第9 條規定之有利不利一律注意原則，亦違背證據法則，違反行政程序法第43條規定之說明理由義務。再者，被告僅因質疑請求項6 及9 記載「接地片」於說明書未充分揭露「接腳」，即作成核駁處分，然「接腳」無關本案之發明目的，無論說明書是否充分揭露，並不影響系爭案可據以實現，且被告縱使質疑說明書未充分揭露「接腳」，允宜依職權闡明其質疑，給予原告申復或通知修正或刪除系爭案申請專利範圍第6 項及第9 項機會，應通知而未通知，逕作成再審查核駁審定，顯非選擇對原告權益損害最小之方法，剝奪原告程序利益，違反行政程序法第7 條之比例原則等語。

（三）聲明：如主文所示。

三、被告抗辯：

（一）系爭案申請專利範圍第6 項及第9 項雖未明示「上排接地片51、下排接地片52透過接腳接地」，惟「上排接地片51、下排接地片52透過接腳接地」之發明，仍在所請發明的射程之內，且係系爭案說明書所載之惟一實施例，故就系爭案申請專利範圍第6 項及第9 項而言，接腳是為接地片之必然構成要件。又原證2 的圖3-59及原證3 【0022】段，並未有將接腳隔空焊接於電路板上之相關教示，且系爭案之上排接地片51、下排接地片52與原證2 第42頁圖3-10所示接地片（mid-plate）之構型迥異，是以，依系爭案第2、3、7 圖所示，欲將上排接地片51、下排接地片52之接腳隔空焊接於轉接電路板6 及電路板8，或採用接腳以外（如側邊鎖扣元件）方式接地，非對所屬技術領域具有通常知識者而言，顯而易見、輕而易舉的事。再者，原

證3 所示新型專利並非系爭案之一部，原告所謂結合原證3 之新型專利，就可以使接地片達成接地之目的與功能云云，已逾越系爭案之申請專利範圍。

(二) 被告於107 年4 月9 日以(107) 智專三(一) 04085 字第10720292100 號審查意見通知函通知原告限期申復，函內闡明說明書【0020】所載與第3 圖、第4 圖及第7 圖之揭示不符，有違專利法第26條第1 項之規定，惟依原告函覆，顯見其對審查意見通知函之闡明不予認同，爰依專利法第46條第1 項之規定，不予專利，則原告所謂「有剝奪原告程序利益之虞，是處分違反比例原則」，難謂有據。又系爭案說明書有關「圖未示」之記載之文義，僅在於表示「各接腳分別自各本體後側延伸，而穿出於絕緣本體11之基座12後方而可焊接於轉接電路板6 及電路板8 」未經圖示，原告主張(圖未示) 表示說明書記載實施例相異於第2 圖、第3 圖、第7 圖所示實施例云云，已逸出文義解釋之範圍，其主張原處分違反行政程序法「有利不利一律注意原則」，認事用法違背證據法則，並無可採。再者，接地片若無接地，無以解決訊號干擾而發生串音的問題，且接地片之本旨即在接地，故原告主張被告忽視系爭案說明書記載接地片發明目的之一在於解決訊號干擾而發生串音的問題，逕認接地片之發明目的僅在於接地，違反應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果云云，亦無可採。

(三) 聲明：原告之訴駁回。

四、法律適用：

按本法中華民國100 年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規

01 定，專利法第149 條第1 項定有明文。查系爭案之申請日為
02 105 年1 月11日，再審查申請日為106 年11月24日，再審查
03 核駁審定日為108 年2 月26日，則系爭案是否違反上述規定
04 ，應以106 年1 月18日修正公布，106 年5 月1 日施行之專
05 利法（下稱：審定時專利法）為斷。

06 五、本件經兩造整理並協議簡化爭點如下：

07 （一）系爭案是否違反審定時專利法第26條第1 項之規定？

08 （二）原處分是否違反行政程序法第7 、9 、43、102 條，專利
09 法第46條第2 項？

10 六、得心證之理由：

11 （一）系爭案技術內容（主要圖式：附圖1）：

12 系爭案係一種插座電連接器，包括屏蔽外殼、絕緣本體、
13 第一組端子、第二組端子、轉接電路板及複數延伸端子。
14 絕緣本體設置於屏蔽外殼內，絕緣本體包含基座及上舌板
15 、下舌板以及分隔板，分隔板與屏蔽外殼頂板之間形成上
16 插接口，分隔板與屏蔽外殼底板之間形成下插接口。第一
17 組端子及第二組端子設置於絕緣本體，轉接電路板位於絕
18 緣本體後方，轉接電路板包括連接第一組端子之上排接點
19 組以及下排接點組。複數延伸端子一側連接下排接點組，
20 複數延伸端子另一側延伸至絕緣本體底部（參系爭案發明
21 摘要，見申請卷第18頁）。

22 （二）系爭案請求項分析：

23 原告於106 年11月24日提出說明書及申請專利範圍修正本
24 ，並經被告審查認為未超出申請時說明書、申請專利範圍
25 或圖式揭露內容，應可准予修正，依修正後之請求項內容
26 做為比對基礎。系爭案請求項共計17項，其中第1 、17項

為獨立項，餘為附屬項，以下就系爭案請求項1-17為技術分析：

請求項1：一種插座電連接器，包括：一屏蔽外殼，包括一容置槽；一絕緣本體，該絕緣本體設置於該屏蔽外殼並位於該容置槽，該絕緣本體包含一基座及一上舌板、一下舌板以及一分隔板，該上舌板、該下舌板以及該分隔板自該基座一側延伸並形成垂直排列，該分隔板介於該上舌板與該下舌板之間，該分隔板與該屏蔽外殼的上半部之間形成一上插接口，該分隔板與該屏蔽外殼的下半部之間形成一下插接口，該基座、該上舌板、該下舌板與該分隔板為一體式結構；一第一組端子，設置於該絕緣本體，該第一組端子包括：複數上排平板端子，該上排平板端子設置於該基座及該上舌板並位於該上舌板之上表面；及複數下排平板端子，各該下排平板端子設置於該基座及該上舌板並位於該上舌板之下表面；一第二組端子，設置於該絕緣本體，該第二組端子包括：複數上排平板端子，各該上排平板端子設置於該基座及該下舌板並位於該下舌板之上表面；及複數下排平板端子，各該下排平板端子設置於該基座及該下舌板並位於該下舌板之下表面；一轉接電路板，位於該容置槽並覆蓋於該基座後方，該轉接電路板包括一連接該第一組端子之上排接點組以及一下排接點組；及複數延伸端子，該些延伸端

子設置於該轉接電路板前方之該基座內，該些延伸端子一側延伸出該基座後側面而連接該下排接點組，該些延伸端子另一側延伸至該基座底部。

請求項2：如請求項1所述之插座電連接器，其中該第一組端子之各該上排平板端子包含一上排接觸段、一上排連接段及一上排焊接段，該上排連接段設置於該基座及該上舌板，該上排接觸段自該上排連接段一側延伸而位於該上舌板之上表面，該上排焊接段自該上排連接段另一側延伸而穿出於該基座後方並連接該上排接點組。

請求項3：如請求項2所述之插座電連接器，其中該第一組端子之各該上排平板端子包含一上排延伸段，該上排延伸段自該上排連接段後側延伸至該上排焊接段。

請求項4：如請求項1所述之插座電連接器，其中該第一組端子之各該下排平板端子包含一下排接觸段、一下排連接段及一下排焊接段，該下排連接段設置於該基座及該上舌板，該下排接觸段自該下排連接段一側延伸而位於該上舌板之下表面，該下排焊接段自該下排連接段另一側延伸而穿出於該基座後方並連接該上排接點組。

請求項5：如請求項4所述之插座電連接器，其中該第一組端子之各該下排平板端子包含一下排延伸段，該下排延伸段自該下排連接段後側延伸至該下排焊接段。

- 01 請求項6：如請求項1所述之插座電連接器，更包含一上
02 排接地片，設置於該絕緣本體且位於該第一組
03 端子之該些上排平板端子與該些下排平板端子
04 之間。
- 05 請求項7：如請求項1所述之插座電連接器，其中該第二
06 組端子之各該上排平板端子包含一上排接觸段
07 、一上排連接段及一上排焊接段，該上排連接
08 段設置於該基座及該下舌板，該上排接觸段自
09 該上排連接段一側延伸而位於該下舌板之上表
10 面，該上排焊接段自該上排連接段另一側延伸
11 而穿出於該基座底部。
- 12 請求項8：如請求項1所述之插座電連接器，其中該第二
13 組端子之各該下排平板端子包含一下排接觸段
14 、一下排連接段及一下排焊接段，該下排連接
15 段設置於該基座及該下舌板，該下排接觸段自
16 該下排連接段一側延伸而位於該下舌板之下表
17 面，該下排焊接段自該下排連接段另一側延伸
18 而穿出於該基座底部。
- 19 請求項9：如請求項1所述之插座電連接器，更包含一下
20 排接地片，設置於該絕緣本體且位於該第二組
21 端子之該些上排平板端子與該些下排平板端子
22 之間。
- 23 請求項10：如請求項1所述之插座電連接器，更包含一電
24 路板，該電路板結合在該絕緣本體底部，該電
25 路板包括複數分別連接該第二組端子與該些延
26 伸端子另一側的接點。

01 請求項11：如請求項1 所述之插座電連接器，其中該第一
02 組端子之該些上排平板端子包含複數上排訊號
03 端子、至少一上排電源端子及至少一上排接地
04 端子，該第一組端子之該些下排平板端子包含
05 複數下排訊號端子、至少一下排電源端子及至
06 少一下排接地端子。

07 請求項12：如請求項11之插座電連接器，其中該第一組端
08 子之該些上排訊號端子位於該上舌板之上表面
09 而傳輸一組第一訊號，該第一組端子之該些下
10 排訊號端子位於該上舌板之下表面而傳輸一組
11 第二訊號，該組第一訊號之傳輸規格為符合該
12 組第二訊號之傳輸規格，該些上排平板端子與
13 該些下排平板端子以該上插接口之中心點為一
14 對稱中心而彼此點對稱。

15 請求項13：如請求項12所述之插座電連接器，其中該第一
16 組端子之該些上排平板端子之排列位置對應於
17 該第一組端子之該些下排平板端子之排列位置
18 。

19 請求項14：如請求項1 所述之插座電連接器，其中該第二
20 組端子之該些上排平板端子包含複數上排訊號
21 端子、至少一上排電源端子及至少一上排接地
22 端子，該第二組端子之該些下排平板端子包含
23 複數下排訊號端子、至少一下排電源端子及至
24 少一下排接地端子。

25 請求項15：如請求項14所述之插座電連接器，其中該第二
26 組端子之該些上排訊號端子位於該下舌板之上

表面而傳輸一組第一訊號，該第二組端子之該些下排訊號端子位於該下舌板之下表面而傳輸一組第二訊號，該組第一訊號之傳輸規格為符合該組第二訊號之傳輸規格，該些上排平板端子與該些下排平板端子以該下插接口之中心點為一對稱中心而彼此點對稱。

請求項16：如請求項15所述之插座電連接器，其中該第二組端子之該些上排平板端子之排列位置對應於該第二組端子之該些下排平板端子之排列位置。

請求項17：一種插座電連接器，包括：一屏蔽外殼，包括一容置槽；一絕緣本體，該絕緣本體設置於該屏蔽外殼並位於該容置槽，該絕緣本體包含一基座及一上舌板、一下舌板以及一分隔板，該上舌板、該下舌板以及該分隔板自該基座一側延伸並形成垂直排列，該分隔板介於該上舌板與該下舌板之間，該分隔板與該屏蔽外殼的上半部之間形成一上插接口，該分隔板與該屏蔽外殼的下半部之間形成一下插接口；一第一組端子，設置於該絕緣本體，該第一組端子包括：複數上排平板端子，各該上排平板端子設置於該基座及該上舌板並位於該上舌板之上表面；及複數下排平板端子，各該下排平板端子設置於該基座及該上舌板並位於該上舌板之下表面；一第二組端子，設置於該絕緣本體，該第二組端子包括：複數上排平板端子，各該上排

01 平板端子設置於該基座及該下舌板並位於該下
02 舌板之上表面，該些上排平板端子包含一延伸
03 而穿出於該基座底部之上排銲接段；及複數下
04 排平板端子，各該下排平板端子設置於該基座
05 及該下舌板並位於該下舌板之下表面；一下金
06 屬片，位於該下舌板中，且位於該第二組端子
07 之該些上排平版端子與該些下排平板端子之間
08 ；及一轉接電路板，位於該容置槽並覆蓋於該
09 基座後方，該轉接電路板之前側面相鄰該基座
10 後側面，該轉接電路板之後側面相鄰該屏蔽外
11 殼後蓋板之內壁面，該轉接電路板包括一連接
12 該第一組端子之上排接點組。

13 (三) 證據分析：

14 原告於本院審理時提出原證2、原證3 證明以接腳以外之
15 方式接地，為申請時之通常知識，茲就原證2、原證3 之
16 技術內容，分析如下：

17 1.原證2（相關圖式：附圖2）：

18 (1)原證2 為西元2014年8 月11日公開之USB TYPE-C Cab
19 le and Connector Specification ,Release 1.0. (
20 通用序列匯流排C 型線纜及連接器規格第1.0 版) 規
21 格書，原證2 公開日早於系爭案之優先權日（104 年
22 1 月15日），可為系爭案之相關先前技術。

23 (2)3.2.2.1 插座的接地片（參考設計）：

24 插座舌片頂部與底部間的訊號是被舌片中的接地片所
25 屏蔽。圖3-10顯示出接地片的設計參考。重要的是需
26 注意接地片的以下功能：

01 ①訊號端子與接地片之間的距離應精確控制，因為該
02 距離的變化恐會嚴重影響連接器的阻抗。

03 ②在特定的設計中，接地片可略為突出舌片的前端面
04 。這樣的設計是為防範舌片前端面因異物誤插入插
05 座而造成損壞。

06 ③接地片必須通過至少兩個接地觸點連接至電路板以
07 達成接地。

08 ④接地片的側緣是與插頭側邊的鎖扣元件相扣合形成
09 接地，藉以降低EMC（電磁相容性）問題。在側邊
10 鎖扣元件與接地片相連接的區域，必須進行適當的
11 表面處理。（見本院卷第108 頁；中文譯文，見本
12 院卷第328 頁）

13 2.原證3（相關圖式：附圖3）：

14 (1)原證3 為104 年1 月11日公告之我國第M493802 「插
15 座電連接器」新型專利案，原證3 公告日早於系爭案
16 之優先權日（104 年1 月15日），可為系爭案之相關
17 先前技術。

18 (2)原證3 係一種插座電連接器，包括絕緣本體、複數上
19 排端子、複數下排端子及接地片；絕緣本體包含基座
20 及舌板，舌板自基座一側延伸，舌板包含上表面及下
21 表面。複數上排端子位於基座及舌板，複數上排端子
22 包含上排接地端子，位於上表面。複數下排端子位於
23 基座及舌板，複數下排端子包含下排接地端子，位於
24 下表面。接地片設置於絕緣本體且位於上排接地端子
25 與下排接地端子之間，其中接地片設置至少一與上排
26 接地端子或下排接地端子接觸之凸起部（原證3 摘要

，見本院卷第169 頁）。

（四）系爭案未違反審定時專利法第26條第1 項之規定：

1.按「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」
、「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」審定時專利法第26條第1、2 項分別定有明文。又專利說明書是否符合明確且充分揭露而可據以實現要件之審查，係指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效（最高行政法院108 年度判字第161 號判決意旨參照）。從而，發明專利申請人依法負有在發明專利說明書明確（明確性）並充分揭露其發明創作技術內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現（可實施性），如發明專利申請人揭露之程度，已達使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，即符合申請專利權之法定要件。

2.系爭案說明書第【0004】段落記載：「現有USB Type-C 插座電連接器皆僅為單一個插接口，形成可供傳輸的USB 3.0 傳輸介面…並無法同時提供多個插頭電連接器插接並傳輸訊號使用的問題。」；第【0006】段落記載：

「綜上所述，本發明藉由轉接電路板作的轉接作用，讓第一組端子與轉接電路板連接後，第一組端子即可利用轉接電路板及轉接電路板下方的複數延伸端子與電路板連接，讓第一組端子可電性連接至電路板，達到減少製造難度與節約材料的效果，並使USB Type-C連接介面的插座電連接器形成上下雙插接口供多個插頭電連接器插接使用」（見申請卷第196、197頁）。可知，系爭案發明目的在於改良習知單一個插接口插座電連接器結構之問題，藉由轉接電路板之轉接作用，使第一組端子可電性連接至電路板，達到減少製造難度與節約材料的效果，形成上下雙插接口之插座電連接器，合先敘明。

3. 系爭案說明書第【0010】至【0013】、【0017】至【0026】段落及第1-8圖已詳細記載插座電連接器之技術特徵：

(1) 系爭案說明書第【0010】段落記載：「參照第1圖、第2圖及第3圖……本發明之插座電連接器100包含屏蔽外殼4、絕緣本體11、第一組端子2、第二組端子3、轉接電路板6及複數延伸端子7。此外，屏蔽外殼4為一中空殼體，屏蔽外殼4包括一容置槽41，絕緣本體11設置於屏蔽外殼4並位於容置槽41，使屏蔽外殼4覆蓋於絕緣本體11外。」之內容；第【0011】段落記載：「請再參閱第2圖、第3圖及第4圖，絕緣本體11包含基座12、上舌板13、下舌板14以及分隔板15，並且，以射出成型（injection molding）的方式形成有基座12、上舌板13、下舌板14以及分隔板15……而分隔板15介於上舌板13與下舌板14之間，

也就是由上至下依序排列上舌板13、分隔板15及下舌板14……上舌板13、分隔板15及下舌板14形成垂直排列構形。此外，分隔板15與屏蔽外殼4 的頂板之間形成上插接口42……分隔板15與屏蔽外殼4 的底板之間形成下插接口43，也就是下插接口43由分隔板15的底部與屏蔽外殼4 的底板、兩側板共同界定形成」之內容（見申請卷第195-196 頁）。可知，插座電連接器具有屏蔽外殼、絕緣本體、第一組端子、第二組端子、轉接電路板及複數延伸端子。屏蔽外殼包括容置槽。絕緣本體設置於屏蔽外殼並位於容置槽，絕緣本體包含上舌板、下舌板以及分隔板，且自基座一側延伸並形成垂直排列，分隔板介於上舌板與下舌板之間，分隔板與屏蔽外殼頂板之間形成上插接口，分隔板與屏蔽外殼底板之間形成下插接口之技術特徵。

(2)系爭案說明書第【0012】段落記載：「請再參閱第2圖、第3圖、第4圖及第5圖……第一組端子2 包括複數上排平板端子21、複數下排平板端子22。第一組端子2 之複數上排平板端子21設置於該基座12及該上舌板13並位於該上舌板13之上表面，複數上排平板端子21可以嵌入成型（insert-molding）的方式與基座12及上舌板13結合。各上排平板端子21包含上排接觸段215 、一上排連接段216 及一上排焊接段217 ……複數上排焊接段217 穿出於基座12並以垂直接腳（Through-hole Technology ）型式連接至轉接電路板6，也就是複數上排焊接段217 穿出於該基座12後方並連接該轉接電路板6 的上排接點組61」之內容；第【

0013】段落記載：「請再參閱第2圖、第3圖、第4圖及第5圖，第一組端子2之複數下排平板端子22設置於該基座12及該上舌板13並位於該上舌板13之下表面，複數下排平板端子22可以嵌入成型（insert-molding）的方式與基座12及上舌板13結合。各下排平板端子22包含下排接觸段225、一下排連接段226及一下排焊接段227……複數下排焊接段227穿出於基座12並以垂直接腳（Through-hole Technology）型式連接至轉接電路板6，也就是複數下排焊接段227穿出於基座12後方並連接轉接電路板6的上排接點組61。」之內容（見申請卷第195頁）。可知，插座電連接器具有第一組端子設置於絕緣本體，第一組端子包括複數上排平板端子及複數下排平板端子，各上排平板端子位於上舌板之上表面，各下排平板端子位於上舌板之下表面，且轉接電路板位於容置槽並覆蓋於基座後方，轉接電路板包括上排接點組以及下排接點組，第一組端子之複數上排平板端子及複數下排平板端子，可以嵌入成型的方式與基座及上舌板結合，各上排平板端子及下排平板端子之結構皆具有接觸段、連接段及焊接段，上排焊接段及下排焊接段穿出於基座後方，並以垂直接腳形式連接至轉接電路板之上排接點組之技術特徵。

(3)系爭案說明書第【0017】段落記載：「請再參閱第2圖、第3圖及第7圖……複數延伸端子7設置於該轉接電路板6前方之該基座12內，複數延伸端子7一側延伸出該基座12後側面而連接該下排接點組62，複數

延伸端子7 另一側延伸至該基座12底部。」之內容；
第【0018】段落記載：「請參閱第2 圖、第3 圖及第
6 圖，第二組端子3 設置於絕緣本體11」之內容；第
【0019】段落記載：「第二組端子3 之複數下排平板
端子32設置於該基座12及該下舌板14並位於該下舌板
14之下表面…各下排平板端子32包含下排接觸段325
、一下排連接段326 及一下排焊接段327 ……複數下
排焊接段327 穿出於基座12並以垂直接腳（Through-
hole Technology ）型式連接至電路板8 。」之內容
；第【0022】段落記載：「請參閱第1 圖、第3 圖及
第4 圖，插座電連接器100 更包含電路板8 ，電路板
8 結合在絕緣本體11底部，電路板8 包括複數分別連
接第二組端子3 與複數延伸端子7 另一側的接點81」
之內容（見申請卷第192 頁背面-193頁）。可知，插
座電連接器具有複數延伸端子一側連接轉接電路板之
下排接點組，另一側延伸至基座底部；第二組端子設
置於絕緣本體，電路板結合在絕緣本體底部，包括複
數分別連接第二組端子與複數延伸端子另一側的接點
。第二組端子包括複數上排平板端子、複數下排平板
端子，各上排平板端子設置於下舌板之上表面，各下
排平板端子設置於下舌板之下表面，各上排平板端子
及下排平板端子之結構皆具有接觸段、連接段及焊接
段，上排焊接段穿出於基座並以表面黏著接腳形式連
接至電路板，下排焊接段穿出於基座並以垂直接腳形
式連接至電路板之技術特徵。

(4)系爭案說明書第【0020】段落記載：「請參閱第2 圖

、第3圖、第5圖及第6圖……插座電連接器100更包含上排接地片51及下排接地片52……上排接地片51可為上金屬片，位於上舌板13中，且位於第一組端子2之複數上排平板端子21與複數下排平板端子22之間，下排接地片52可為一下金屬片，位於該下舌板14中，且位於第二組端子3之複數上排平板端子31與複數下排平板端子32之間。……當第一組端子2之複數上排平板端子21與複數下排平板端子22，以及第二組端子3之複數上排平板端子31與複數下排平板端子32在傳輸訊號時，可藉由上排接地片51與下排接地片52的隔離，改善複數上排平板端子21/31之間以及複數下排平板端子22/32之間訊號干擾而發生串音的問題，同時，亦可利用上排接地片51與下排接地片52分別位於上舌板13與下舌板14而提升上舌板13與下舌板14本身的結構強度……」之內容；第【0021】段落記載：「請參閱第2圖、第3圖及第4圖，插座電連接器100更包含中央接地片44，中央接地片44為一口字型的金屬片體，中央接地片44覆蓋在分隔板15上，中央接地片44側端為電性連接屏蔽外殼4，中央接地片44可接觸插頭電連接器並經由屏蔽外殼4傳導與接地，同時中央接地片44可提供強化分隔板15的作用。」之內容（見申請卷第192頁背面-193頁背面）。可知，插座電連接器包含上排接地片51及下排接地片52，分別位於第一組端子之複數上排平板端子21與複數下排平板端子22之間，及第二組端子之複數上排平板端子31與複數下排平板端子32之間，可改善複數上排平板端

子21/31 之間以及複數下排平板端子22/32 之間訊號干擾而發生串音的問題，而中央接地片覆蓋在分隔板上，可接觸插頭電連接器經由屏蔽外殼傳導與接地之結構特徵。

(5)系爭案說明書第【0023】段落記載：「……由第一組端子2 之複數上排平板端子21之前視觀之，複數上排平板端子21由左側至右側依序為上排接地端子213（Gnd）、第一對差動訊號端子211（TX1+-）、第二對差動訊號端子211（D+-）、第三對差動訊號端子211（RX2+-），以及三對差動訊號端子211 之間的上排電源端子212（Power /VBUS）、保留端子（RFU）及最右側之上排接地端子213（Gnd）……」之內容；第【0024】段落記載：「在此，第二組端子3 之複數上排平板端子31亦為相同第一組端子2 而將複數上排平板端子31所包含複數上排訊號端子311、至少一上排電源端子312 及至少一上排接地端子313 的端子型式，在此不多加贅述。」之內容；第【0025】段落記載：「請再參考第1 圖、第2 圖、第9 圖及第10圖……複數下排平板端子22由右側至左側依序為下排接地端子223（Gnd）、第一對差動訊號端子221（TX2+-）、第二對差動訊號端子221（D+-）、第三對差動訊號端子221（RX1+-），以及三對差動訊號端子221 之間的下排電源端子222（Power /VBUS）、保留端子（RFU）及最左側之下排接地端子223（Gnd）……」之內容；第【0026】段落記載：「第二組端子3 之複數下排平板端子32亦為相同第一組端

子2，將複數下排平板端子32包含複數下排訊號端子321、至少一下排電源端子322及至少一下排接地端子323的端子型式，在此不多加贅述。」之內容（見申請卷第191頁背面-192頁背面）。可知，插座電連接器具有包含第一組端子及第二組端子之上排平板端子排列順序，由左至右為上排接地端子（Gnd）、第一對差動訊號端子（TX1+ -）、第二對差動訊號端子（D+ -）、第三對差動訊號端子（RX2+-），以及三對差動訊號端子之間的上排電源端子（Power /VBUS）、保留端子（RFU）及最右側之上排接地端子（Gnd）；而下排平板端子排列順序由右至左為下排接地端子（Gnd）、第一對差動訊號端子（TX2+-）、第二對差動訊號端子（D+-）、第三對差動訊號端子（RX1+-），以及三對差動訊號端子之間的下排電源端子（Power /VBUS）、保留端子（RFU）及最左側之下排接地端子（Gnd）之技術特徵。

(6)綜上，系爭案之發明目的、功效，乃在於改良習知單一個插接口插座電連接器結構之問題，藉由轉接電路板之轉接作用，使第一組端子可電性連接至電路板，達到減少製造難度與節約材料的效果，形成上下雙插接口之插座連接器。又依系爭案說明書上開段落內容，已揭露插座電連接器各元件之連結關係及相對位置，且平板端子可以嵌入成型的方式與基座及上舌板結合，其焊接段可以垂直接腳或表面黏著接腳形式連接至轉接電路板或電路板之技術特徵。是以，系爭案發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請

專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，並據以實現一種具上下雙插接口插座電連接器，供多個插頭電連接器插接使用，而製造或使用申請專利之發明，解決問題，且可產生預期的功效，故系爭案說明書之記載已明確且充分揭露上開技術特徵，符合審定時專利法第26條第1項規定。

（五）被告抗辯之論駁：

1. 被告抗辯：上排接地片、下排接地片透過接腳接地之發明係為系爭案說明書所載之惟一實施例，故就系爭案申請專利範圍第6項及第9項而言，接腳為接地片之必然構成要件云云（見本院卷第218-219頁）。惟查，系爭案申請專利範圍第6項及第9項記載之上排接地片及下排接地片，乃定義接地片之位置，係位於上排平板端子與下排平板端子之間，並藉由上排接地片及下排接地片之接地，改善傳輸高速訊號時，端子之間發生串音之問題。至於接地之形式或方法，則應視說明書揭露之內容與申請時之通常知識是否可合理預測或延伸，此經參酌系爭案說明書第【0020】段落記載：「上排接地片51及下排接地片52皆分別包含本體、突出本體兩側之扣勾及本體後側延伸之複數接腳……各接腳分別自各本體後側延伸，而穿出於絕緣本體11之基座12後方而可焊接於轉接電路板6及電路板8（圖未示）。上排接地片51與下排接地片52的兩側扣勾分別為突出上舌板13及下舌板14兩側，當插頭電連接器插入插座電連接器100時，插頭電連接器的兩側彈片接觸兩側扣勾」之內容（見申請卷

第192 頁），已揭露接地片可透過接腳穿出於絕緣本體之基座後方而焊接於轉接電路板及電路板之技術特徵。佐以，原證2 亦記載：「接地片的側緣是與插頭側邊的鎖扣元件相扣合形成接地，藉以降低EMC（電磁相容性）問題。」、「側邊鎖扣元件（固定鎖扣元件）是位於插頭中…側邊鎖扣元件應接觸插座接地片，藉以提供額外的接地迴路」之內容（見本院卷第108-109 頁；中文譯文，見本院卷第328-329 頁）。是以，系爭案揭露之接地片兩側扣勾結構，即可與插頭連接器的側邊鎖扣元件扣合而接地，即可改善傳輸高速訊號時，端子之間發生串音之問題。被告上開所辯，尚無可取。

2. 被告抗辯：依系爭案第2、3、7 圖所示，欲將上排接地片51、下排接地片52之接腳隔空焊接於轉接電路板6及電路板8，對於所屬技術領域具有通常知識者而言，非是顯而易見云云（見本院卷第219 頁）。惟查，系爭案圖式固未繪製接地片接腳結構，然由說明書第【0020】段落之前揭記載，已揭露接腳位於接地片本體後側，且可向後延伸而穿出於絕緣本體之基座後方而可焊接於轉接電路板6及電路板8之技術特徵（見申請卷第192 頁、第193 頁背面），對於發明所屬技術領域中具通常知識者而言，應可瞭解如何將接腳焊接於轉接電路板及電路板，且無須過度實驗即可據以實現。又參酌說明書第【0012】、【0013】等段落之前揭記載，已揭露第一組端子之複數個上排焊接段及複數個下排焊接段穿出於基座後方並以垂直接腳（Through-hole Technology）形式連接轉接電路板的上排接組點之技術特徵（見申請

卷第195 頁)；第【0014】段落記載「…在一些實施例中，上排接點組61以及下排接點組62亦可進一步皆為表面焊點型式，提供第一組端子2 之複數上排焊接段217、複數下排焊接段227 以及複數延伸端子7 以表面黏著接腳 (Surface Mount Technology) 型式連接…」之內容 (見申請卷第194 頁、第195 頁背面)，揭露上排接點組以及下排接點組亦可進一步皆為表面焊點型式，提供第一組端子之複數上排焊接段、複數下排焊接段以及複數延伸端子以表面黏著接腳 (Surface Mount Technology) 型式連接之技術特徵；說明書第【0018】、【0019】段落之前揭記載，揭露第二組端子之複數個上排焊接段穿出於基座並以表面黏著接腳 (Surface Mount Technology) 形式連接至電路板、複數下排焊接段以及複數延伸端子以表面黏著接腳 (Surface Mount Technology) 型式連接至電路板、複數下排焊接段穿出於基座並以垂直接腳 (Through-hole Technology) 形式連接電路板之技術特徵 (見申請卷第193 頁)，則發明所屬技術領域中具通常知識者，即可參酌第一組端子及第二組端子之平板端子的焊接方式，理解如何將上排接地片與下排接地片之接腳焊接於轉接電路板及電路板，且無須過度實驗即可據以實現。被告上開所辯，尚不可採。

3. 被告抗辯：原證2 圖3-59及原證3 第【0022】段落未有將接腳隔空焊接於電路板上之相關教示云云 (見本院卷第220 頁)。惟按申請專利之發明倘為所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識所能輕易完成，申請人尚得提供輔助性證

明資料用以證明。查原證2 第97頁第3 點揭示「接地片應使用至少3 支或更多的焊腳，藉以直接地插接至电路板的接地面」之技術特徵（見本院卷第163 頁；中文譯文，見本院卷第329 頁）；又圖3-59繪製接地片以3 支焊腳插接至电路板的接地面之技術特徵，且原證3 第【0022】段落記載：「接地片51包含本體511 及本體51 1一側之複數接腳512。本體511 為一片體，位於舌板212 而介於上排接地端子313 與下排接地端子413 之間。複數接腳512 延伸於本體511 之後方的兩側，複數接腳512 外露於基座211 而成為DIP 接腳使用，並且，複數接腳512 可焊接於电路板（圖未示）」之內容（見本院卷第180 頁），亦有揭露將接腳焊接於电路板之相關教示。被告上開所辯，自無可取。

4. 被告抗辯：系爭案說明書及圖式未有「接地片的側邊與插頭電連接器的側邊鎖扣元件相扣合形成接地」之揭示，且系爭案之上排接地片51、下排接地片52與原證2 第42頁圖3-10所示接地片之構型迥異。復依系爭案說明書所載之惟一接地實施例，當系爭案之上排接地片51、下排接地片52既已透過接腳接地後，自無另行將「接地片的側邊與插頭電連接器的側邊鎖扣元件相扣合形成接地」之想云云（見本院卷第221 頁）。惟查，原證2 第42頁第16-17 行記載：「接地片的側緣是與插頭側邊的鎖扣元件相扣合形成接地，藉以降低EMC（電磁相容性）問題」之內容（見本院卷第108 頁；中文譯文，見本院卷第328 頁）；第43頁第3-4 行記載：「側邊鎖扣元件（固定鎖扣元件）是位於插頭中…插頭側邊鎖扣元件應

01 接觸插座接地片，藉以提供額外的接地迴路。」之內容
02 （見本院卷第109 頁；中文譯文，見本院卷第329 頁）
03 ；第97頁第3-4 行記載：「接地片應使用至少3 支或更
04 多的焊腳，藉以直接地插接至電路板的接地面」之內容
05 （見本院卷第163 頁；中文譯文，見本院卷第329 頁）
06 ，已揭示接地片之接腳接地後，其兩側扣勾仍可與插頭
07 連接器的側邊鎖扣元件扣合而接地，以提供額外的接地
08 迴路之技術特徵。被告上開所辯，自無可採。

09 5.被告抗辯：圖未示就是圖沒有表示，而不是另有什麼真
10 意，在核駁先行通知書已有寫的很清楚，且今日庭呈簡
11 報第10頁第3 圖（紅色表示：下接地片）或第11頁第7
12 圖（綠色表示：上接地片），都跟電路板沒有接觸到，
13 所以沒有接地，也無法焊接，不管是水平或垂直距離都
14 有差距存在，被告在審查時就有以核駁通知書通知原告
15 這樣的圖式無法達到接地的效果，但是原告就認為是可
16 以據以實施，沒有補正或修正，才因而駁回原告的申請
17 云云（見本院卷第317 、319 頁）。惟查，說明書第【
18 0020】段落之前揭記載，已揭露接地片之接腳穿出於絕
19 緣本體之基座後方而焊接於轉接電路板及電路板之技術
20 特徵，因此，說明書所記載「圖未示」，僅係指圖式中
21 並未繪製接地片之接腳穿出於絕緣本體之基座後方而焊
22 接於轉接電路板及電路板之結構，且發明所屬技術領域
23 中具通常知識者，依說明書所載內容亦可輕易理解如何
24 將接地片之接腳焊接於轉接電路板及電路板以達成接地
25 ，且無須過度實驗即可據以實現，改善串音的問題。被
26 告抗辯，亦無可取。

01 6.被告抗辯：原證2 之接地片具有彈片（即原告所稱側邊
02 鎖扣元件）、勾扣，此與系爭案不同，且原證2 第97頁
03 第3 至4 行揭示接地片應透過3 條或更多焊腳連接於電
04 路板接地面，而系爭案只有2 個接腳云云（見本院卷第
05 414-415 頁）。惟查，依說明書第【0020】段落前揭記
06 載：「上排接地片51與下排接地片52的兩側『扣勾』分
07 別為突出上舌板13及下舌板14兩側，當插頭電連接器插
08 入插座電連接器100 時，插頭電連接器的兩側『彈片』
09 接觸兩側『扣勾』」之內容（見申請卷第192 頁），此
10 與原證2 第42頁第16行所載：「接地片的側緣是與插頭
11 側邊的鎖扣元件相扣合形成接地」之內容（見本院卷第
12 108 頁；中文譯文，見本院卷第328 頁）及第43頁第3
13 -4行所載：「側邊鎖扣元件（固定鎖扣元件）是位於插
14 頭中…插頭側邊鎖扣元件應接觸插座接地片，藉以提供
15 額外的接地迴路。」之內容相符（見本院卷第109 頁；
16 中文譯文，見本院卷第329 頁）。雖原證2 並未揭示使
17 用至少3 條接腳，惟原證2 第42頁第14-15 行已記載建
18 議接地片以至少2 個接觸點直接連接至電路板以達接地
19 之內容（見本院卷第108 頁；中文譯文，見本院卷第32
20 8 頁），故接腳數量為系爭案之2 條或原證2 所示之3
21 條，亦為發明所屬技術領域中具通常知識者，可自行依
22 發明需求而能輕易調整。被告上開所辯，亦無可採。

23 （六）原處分並未違反行政程序法第7 、9 、43、102 條，專利
24 法第46條第2 項等規定：

25 1.按「行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應
26 有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法

時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」、「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意」、「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人」、「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」，行政程序法第7、9、43、102條分別定有明文。次按，「專利專責機關為前項審定前，應通知申請人限期申復；屆期未申復者，逕為不予專利之審定」，專利法第46條第2項亦有明文。

- 2.原告主張：原處分單憑形式問題而不予專利，未考量本案請求項1至17，於現在時點並未發現不予專利理由，允宜透過職權闡明或再次通知原告針對形式疑慮修正等方法，卻逕為拒絕處分，顯非選擇對原告權益損害最小之方法，且有剝奪原告程序利益之虞，原處分違反比例原則云云（見本院卷第69-70頁）。惟查，依審定時專利法第46條規定，發明專利申請案若違反同法第26條之規定，應為不予專利之審定，故審定時專利法第26條第1項自非原告所稱單純形式問題，合先敘明。又原告於105年1月11日提起系爭案申請，被告以106年3月29日（106）智專一（六）05160字第10620343890號審查意見通知函（見申請卷第85-91頁）通知原告為申復

，並於原告申復後，以106 年9 月22日（106 ）智專一（六）05160 字第10620974700 號核駁審定書為不予專利之審定（見申請卷第146-148 頁），原告嗣於106 年11月24日提出再審查申請，被告再於107 年4 月9 日（107 ）智專三（一）04085 字第10720292100 號審查意見通知函（下稱：107 年4 月9 日函）通知原告系爭案說明書有不符專利法第26條第1 、4 項之規定之情事，請原告於文到次日起2 個月內提出修正、申復說明或有關反證資料（見申請卷第187 頁、第187 頁背面）。準此，原告雖於107 年6 月8 日提出申復理由書暨說明書修正本（見申請卷第188-211 頁），惟其內容，除修正說明書段落【0028】關於下排平板端子與上排平板端子之元件符號記載外（對應原審查意見通知函說明一、（二）、2.和3.關於違反專利法第26條第4 項部分），就是否違反審定時專利法第26條第1 項規定一節，陳稱「接腳未記載於申請專利範圍，而說明書是否符合可據以實現要件，係以申請專利之發明為對象」、「由本案說明書及圖式可知，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，亦能瞭解上排接地片51及下排接地片52的接腳如何焊接於轉接電路板6 及電路板8 的內容，並可據以實現」云云，並未再就審定時專利法第26條第1 項部分為說明書之修正，堪認被告於作成不予專利之審定前，業已告知原告理由，惟原告仍堅持未就審查意見通知進行修正，則被告據此作成不予專利之審定，難認未為職權闡明或有剝奪原告程序利益之情形，自無違反行政程序法第7 條比例原則可言。

01 3.原告主張：原處分未注意說明書中對於原告有利之客觀
02 記載，卻主觀上逕自憑空臆測申請專利範圍所無記載之
03 發明以及曲解圖式所未繪示之實施例，顯有認定事實不
04 憑卷內證據之違背法令云云（見本院卷第70-71 頁）。
05 惟查，本院固認系爭案未違反審定時專利法第26條第1
06 項之規定，而與原處分與訴願決定之認定有異，然據以
07 認定之依據均為系爭案說明書之記載是否明確、可否據
08 以實現，雖本院與被告與經濟部訴願委員會之認定不同
09 ，然二者差異僅係源於系爭案之說明書內容是否明確揭
10 露接腳接地方式之問題上，尚不得以此遽謂被告作成系
11 爭案不予專利之審定，有何違反行政程序法第9 條、第
12 43條之餘地。

13 4.原告主張：原處分所持「接地片若無接腳則無由接地，
14 接腳為接地片之構成要件」、「圖式之接腳與電路板無
15 焊接可能，說明書係虛偽不實」等理由未見於被告107
16 年4 月9 日審查意見通知函，並未給予原告適時申復及
17 修正機會，亦未給予原告陳述意見機會，違反專利法第
18 46條第2 項，行政程序法第102 條規定云云（見本院卷
19 第343 、376-379 頁）。惟查：

20 (1)被告107 年4 月9 日通知函已敘明：「本案說明書不
21 符專利法第26條第1 、4 項之規定。1.本案說明書【
22 0020】所載“參閱第2 圖、第3 圖、第5 圖及第6 圖
23 ……上排接地片51及下排接地片52皆分別包含本體…
24 …及本體後側延伸之複數接腳……各接腳分別自各本
25 體後側延伸，而穿出於絕緣本體11之基座12後方而可
26 焊接於轉接電路板6 及電路板8 ”與第3 圖、第4 圖

01 及第7圖之揭示不符，有違專利法第26條第1項之規定。
02 定。」（見申請卷第187頁、第187頁背面），嗣後
03 原處分即再審查核駁審定書，基於認定系爭案不符審
04 定時專利法第26條第1項規定而肯認初審所為不予專
05 利之審定，綜觀其內容亦僅對於原告之申復理由為補
06 充說明，並未逸脫原審查意見通知函之意旨。是以，
07 被告既已於審查意見通知函中敘明系爭案說明書不符
08 審定時專利法第26條第1項之理由，並給予原告陳述
09 意見之機會，原告不知適時補充或修正，率為指摘被
10 告於系爭案之審查，違反專利法第46條第2項，行政
11 程序法第102條規定云云，要無可取。

12 (2)原告主張：審查意見通知函的審查對象是106年修正
13 本，而原處分的審查對象是107年修正本，二者審查
14 對象不同，且審查意見通知函未提及系爭案請求項6
15 及請求項9，亦未說明其認定本案接腳為接地片之構
16 成要件，無焊接可能，及說明書係虛偽不實等理由云
17 云（見本院卷第393頁）。惟查，被告已踐行審定時
18 專利法第46條第2項規定，通知原告限期申復，原告
19 並提出申復理由書（見申請卷第208-211頁），惟如
20 前述，原告僅修正說明書段落【0028】關於下排平板
21 端子與上排平板端子之元件符號記載外，就被告所指
22 違反審定時專利法第26條第1項規定部分，仍堅持系
23 爭案說明書之技術內容已明確且充分揭露，故原告並
24 未依被告所認定之「系爭案說明書不符合專利法第26
25 條第1項」意見修改說明書。準此，原告提出之系爭
26 案106年修正本與107年修正本之差異，僅係在上、

01 下排平板端子之符號，則原告未依審查意見通知函為
02 修正，被告經審視認原告無法克服審查意見通知函所
03 指出之不准專利事由，自可依審定時專利法第46條第
04 1項依職權給予不予專利之審定。又原告另主張審查
05 意見通知函並未提及系爭案申請專利範圍第6項及第
06 9項云云，然系爭案請求項6、9記載者，實為原告
07 於申復理由中主張之「接腳並未記載於申請專利範圍
08 」，而原處分之「接地片若無接腳則無由接地，接腳
09 為接地片之構成要件」、「圖式之接腳與電路板無焊
10 接可能，說明書係虛偽不實」等理由，均係回應原告
11 之申復理由，故原處分內容並未超出審查意見通知函
12 內容之範圍。從而，原告指摘被告未給予其陳述意見
13 機會云云，並非事實，無可採信。

14 七、綜上所述，系爭案申請專利範圍第6項及第9項對應之發明
15 說明，已明確且充分揭露接地片之接腳如何達成接地之方式
16 ，而所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利
17 範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無
18 須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用系爭案之發
19 明，解決問題，並且產生預期的功效，應無違反審定時專利
20 法第26條第1項之規定。故被告以系爭案之申請違反審定時
21 專利法第26條第1項之規定，不符法定專利要件，而為不予
22 專利之審定，於法即有未合。訴願決定予以維持，亦有違誤
23 。從而，原告訴請如主文所示之判決，為有理由，應予准許
24 。

25 八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無
26 影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中華民國 109 年 3 月 18 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官 蔡惠如

法官 黃珮茹

法官 張銘晃

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專

01		利代理人者。
02		
03	(二)非律師具有右列情	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、
04	形之一，經最高行	二親等內之姻親具備律師資格者。
05	政法院認為適當者	2.稅務行政事件，具備會計師資格者
06	，亦得為上訴審訴	。
07	訟代理人	3.專利行政事件，具備專利師資格或
08		依法得為專利代理人者。
09		4.上訴人為公法人、中央或地方機關
10		、公法上之非法人團體時，其所屬
11		專任人員辦理法制、法務、訴願業
12		務或與訴訟事件相關業務者。
13		
14	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴	
15	人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明	
16	文書影本及委任書。	
17		

中 華 民 國 109 年 3 月 18 日
書記官 葉倩如